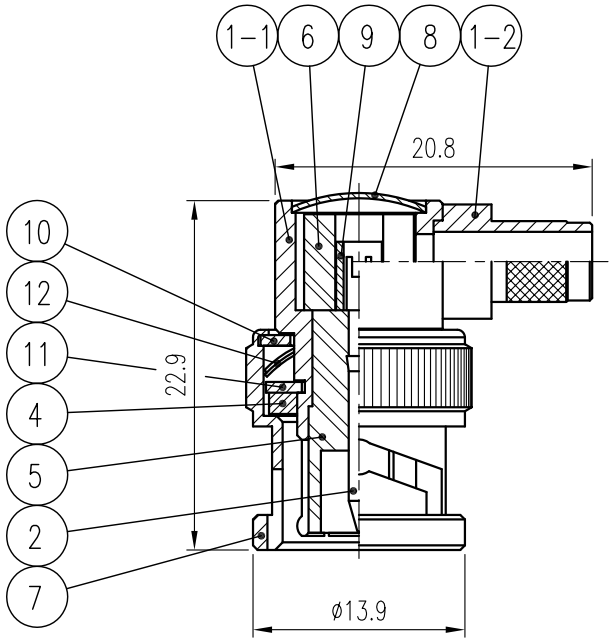
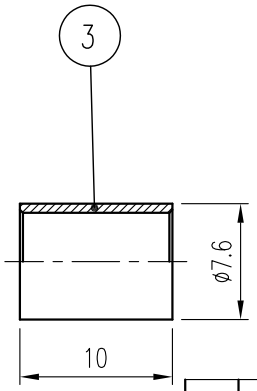
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





12		SPRING RING	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-5/1 (R6001)	
11		WASHER	2	BsS	Nickel Plate	DWA00016-5/1 (Q6002)	
10		WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00015-5/1 (Q6001)	
9		INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00086-5/1 (M6007)	
8		COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00053-5/1 (L6003)	
7		BNC CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-5/1 (K6001)	
6		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00541-N/1 (H6083)	
5		INSULATOR	1	TEFLON		DIN00434-N/1 (H6013)	
4		GASKET	1	SILICOM		DGK00012-N/1 (G6001)	
3		FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00065-5/1 (F6001)	
2		CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00581-5/1 (E6009)	
1	1-2	BODY B	1	MBsBD	Nickel Plate	DBB00136-5/1	DBD01304-3/1
	1-1	BODY A	1	MBsBD	Nickel Plate		DBD00657-3/1
대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2003. 1. 22.	KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	승인		
재질	검도		도명 BNC-LPC-59
열처리	제도		
보호피막처리	작성부서	연 구 소	A4 도번 CN00346-7/1
	척도 2/1	단위 mm	중량 — K327-111-000